

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2024年9月10日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	望正资产 马丁、生命保险资管 黄进、东北证券 吴源恒、东北证券 吴雨萌	
会议时间	2024年9月10日 10:00-11:00	
会议地点	佰维存储三楼会议室	
上市公司接待人员姓名	战略部总监 肖博天 董办工作人员	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1. 2024年上半年，公司营业收入按照产品结构该如何划分？ A1: 2024年上半年，公司嵌入式存储产品占营业总收入的比例为63%，PC存储产品占比30%，工车规存储产品占比2%，先进封测服务占比2%，其他占比3%。</p> <p>Q2. 公司自2023年底以来一直保持较为平稳的库存水平，请问下半年公司的备货策略是否会有所调整？ A2: 2024年上半年公司存货35.74亿元，与2024年Q1末基本持平，期间内，公司持续加强存货管理，制定了合理的存货水平，提高了周转效率。自2024年以来，公司采取较为中性的备货策略，按需采购。展望下半年，公司预计将继续保持按需采购的备货策略。</p> <p>Q3. 公司的封装技术能力处于什么水平？如何赋能产品提高竞争力？ A3: 公司掌握16层叠Die、30~40μm超薄Die、多芯片异构集成等先进封装工艺，为NAND、DRAM芯片和SiP封装产品的创新力及大规模量产提供支持。公司拥有资深封装设计和工艺研发团队，有能力进行完备的基板级和封装级仿真。在封装工艺领域，公司不断引进先进封装设备、失效分析设备和芯片可靠性实验设备，大力投入先进工艺研究，攻克了FC工艺、CSP工艺、POP、PIP和3DSiP以及封装电磁屏蔽等工艺技术。公司基于上述工艺的创新和组合，使得拥有复杂系统的存储芯片在体积、散热、电磁兼容性、可靠性、存储容量等方面拥有较强的市场竞争力，使公司产品尤其是嵌入式存储产品实现行业领先的产品创新能力和可靠性。</p> <p>Q4. 公司的晶圆级先进封测制造项目主要构建了哪些技术能力？目前有什么最新进展？</p>	

	<p>A4: 公司在存储芯片和逻辑整合封装、测试研发等领域积累了多年的技术基础, 已经开展了相关技术的开发, 包括: 多层高密度线宽 RDL 技术、小间距 uBump、以及 3D 堆叠等先进封装技术。该项目尚处于前期投入阶段, 正在建设中, 预计将于 2025 年投产, 为客户提供整套的先进封装测试解决方案。</p> <p>Q5. 公司在智能穿戴领域目前已进入哪些客户? 产品有哪些优势? Meta Ray-Ban 眼镜已经批量出货, 公司在其中供应什么产品?</p> <p>A5: 公司在智能穿戴领域目前已进入 Google、Meta、小米、小天才等知名企业, 产品应用于其智能手表、智能眼镜等。公司研发封测一体化的布局, 在智能可穿戴领域具有较强的竞争优势, 能够在低功耗、快响应等方面进行固件算法优化设计的同时, 通过先进封测工艺能力, 助力产品的轻薄小巧。其中, 公司为 Ray-Ban Meta 眼镜提供 ROM+RAM 存储器。</p> <p>Q6. 公司与 HP、Acer、Predator、Lenovo 等品牌的合作模式如何? 有什么竞争优势?</p> <p>A6: 公司先后获得惠普 (HP)、宏碁 (Acer)、掠夺者 (Predator) 等国际知名品牌的存储器产品全球运营授权及联想 (Lenovo) 在海外区域市场的存储器产品运营授权, 由公司独立进行相关产品的设计、研发、生产和市场推广、销售。在授权品牌运营方面, 公司有两大突出优势: 一方面公司拥有从产品规划、设计开发到先进制造的全栈能力, 产品线囊括 NAND、DRAM 的各个品类; 另一方面公司拥有覆盖全球主要市场的营销网络, 以及本地化的产品和市场营销队伍、经销商伙伴, 具备面向全球市场进行产品推广与销售的能力。</p> <p>Q7. 公司上半年研发投入占比多少? 取得哪些研发成果?</p> <p>A7: 2024 年上半年, 公司研发费用占公司营收比例为 6.11%。截至 2024 年 6 月 30 日, 公司共取得 335 项境内外专利和 44 项软件著作权, 其中专利包括 112 项发明专利、160 项实用新型专利、63 项外观设计专利。2024 年 1-6 月新增申请发明专利 45 项, 新增授权发明专利 17 项。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 9 月 10 日
备注	接待过程中, 公司与投资者进行了充分的交流与沟通, 并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定, 保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平, 没有出现未公开重大信息披露等情况。